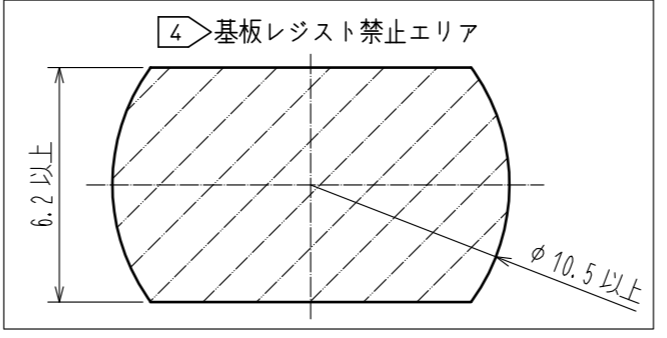
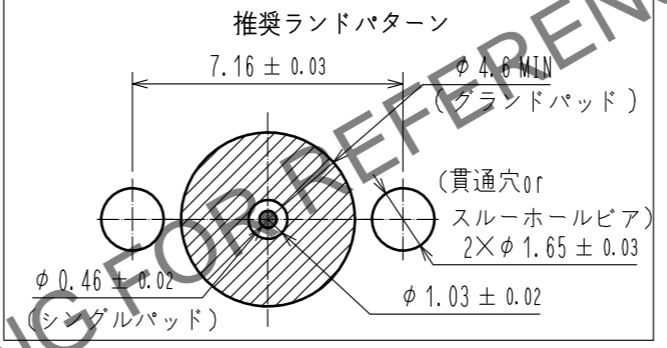
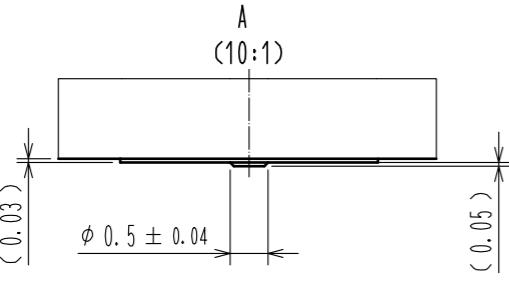
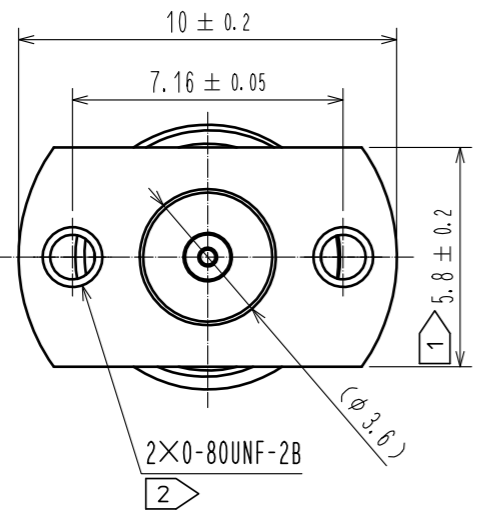
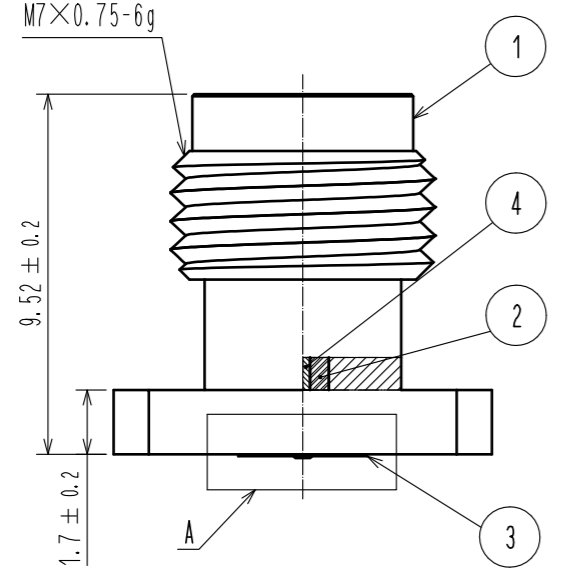
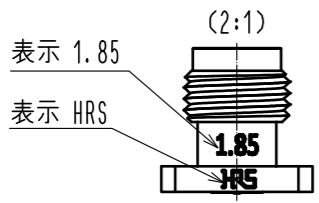
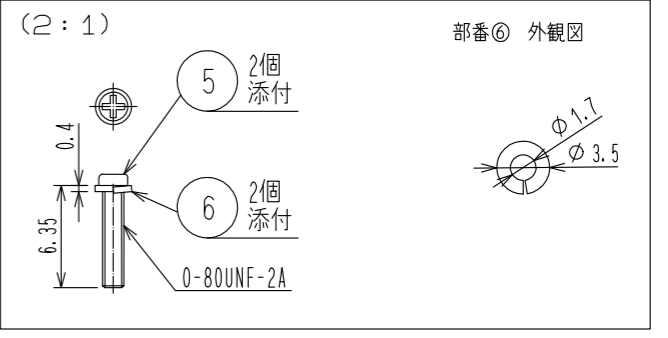
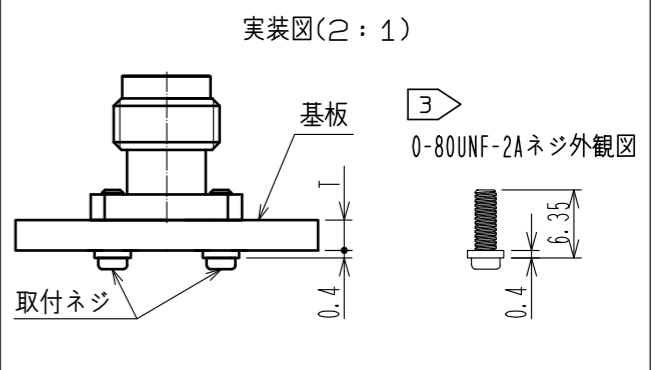


Jan.1.2025 Copyright 2025 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 1 嵌合を行う際は、基板実装部へのトルクによる負荷をかけないよう、フランジ部をスパナ等で保持して下さい。
- 2 0-80UNF-2Bねじの推奨締め付けトルクは0.09N・mとなります。片側づつ交互均等に締めていき、最後に両側増し締めして下さい。
- 3 コネクタ取付に使用するねじ(添付品)は、基板厚さT=2.4-4.25mmに対応しております。
- 4 図示のコネクタフランジ面の内側に、レジストを施さないで下さい。
5. ランドパターンや信号ビア形状は基材の誘電率、板厚、層構成に依存します。良好な高周波特性を実現するためにコネクタを含めたPCBレイアウトで高周波解析を推奨します。
- △6. 高速伝送基板を測定する試作評価用のはんだレス実装コネクタとなり、製品へ搭載してのご使用は推奨しておりません。



3	ステンレス鋼	金めっき	6	ステンレス鋼	スプリングワッシャー
2	PTFE樹脂		5	鋼	0-80UNF-2A ねじ
1	ステンレス鋼	バッシペイト	4	ベリリウム銅	金めっき
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS	mm	SCALE	5:1	COUNT	1
DESCRIPTION OF REVISIONS			DESIGNED	RO. YOKOYAMA	CHECKED
DIS-D-00016663			DATE	20230818	
APPROVED : TS. NOBE			20190108	DRAWING NO. ADC-380932-11-00	
CHECKED : MH. OGUSU			20190108	PART NO. HV-R-SR2(11)	
DESIGNED : AH. MARUYAMA			20190108	CODE NO. CL0338-0010-0-11	
DRAWN : AH. MARUYAMA			20190108	1/1	